

Rambus, 한국서 차세대메모리 공개

데이터 전송률 3.2Gbps로 DDR3 2배 ... 전력 사용량도 7W로 적어

미국 메모리반도체 솔루션 기업 Rambus가 한국에서 차세대 메모리를 공개했다.

Rambus 8월18일 서울 그랜드 인터컨티넨탈호텔에서 컴퓨터 메인 메모리 데이터 전송률을 DDR3의 2배인 3.2Gbps까지 끌어올린 차세대 메모리를 공개했다.

Rambus가 공개한 차세대 메모리는 DDR3 D램보다 구동 속도가 빠르지만 전력 사용량과 대기전력은 각각 7W, 0.8W로 크게 줄었다고 설명했다.

마이클 칭 Rambus 전략개발 이사는 “차세대 메모리는 2-4배 이상 용량을 개선했다”며 “새로운 세대의 컴퓨팅 플랫폼이 도래하는 데 이바지할 것”으로 기대했다.

Rambus는 메인 메모리 로드맵에 DDR3에 사용된 디렉트 스트로빙 기술의 속도 제한 문제를 해결해 데이터 전송 속도를 높인 플렉스페이스와 메모리 효율을 높이고 D램 코어 소비전력을 줄이는 모듈 스테딩 기술을 채용했다.

램버스는 컴퓨터 환경이 멀티 코어, 그래픽, 게임 등으로 확장되고 있어 2011년이면 DDR3를 뛰어넘는 기술이 일반화할 것으로 전망했다.

Rambus는 관련 기술과 메모리 솔루션에 관한 내용을 담은 백서를 홈페이지(www.rambus.com)에 올려 누구나 내려 받을 수 있도록 했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2009/08/19>